



Vorstellung der Firma

Werk in Hranice

SSI SCHÄFER

Think Tomorrow.

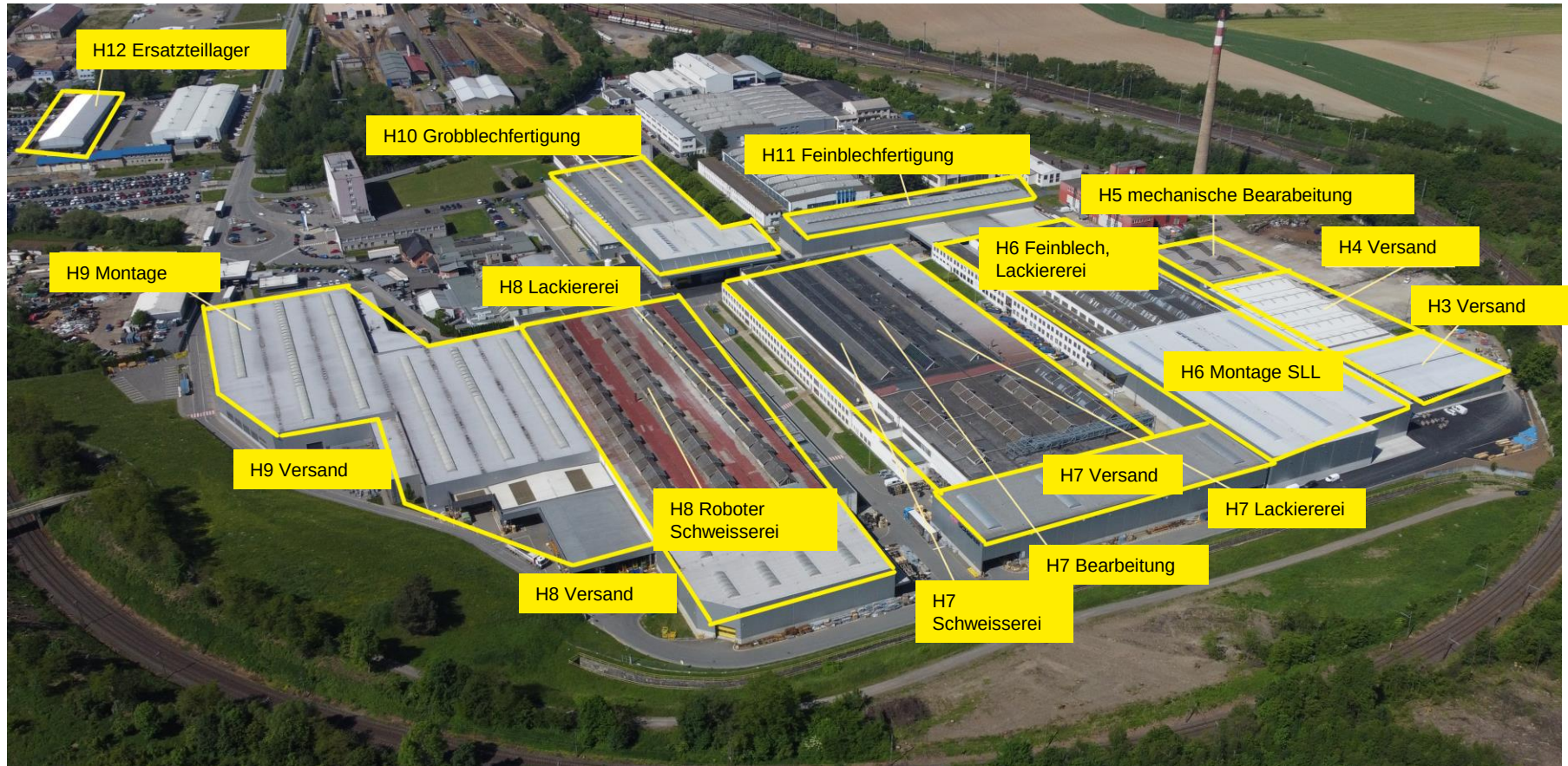
SSI SCHÄFER HRANICE



Werk



Übersicht

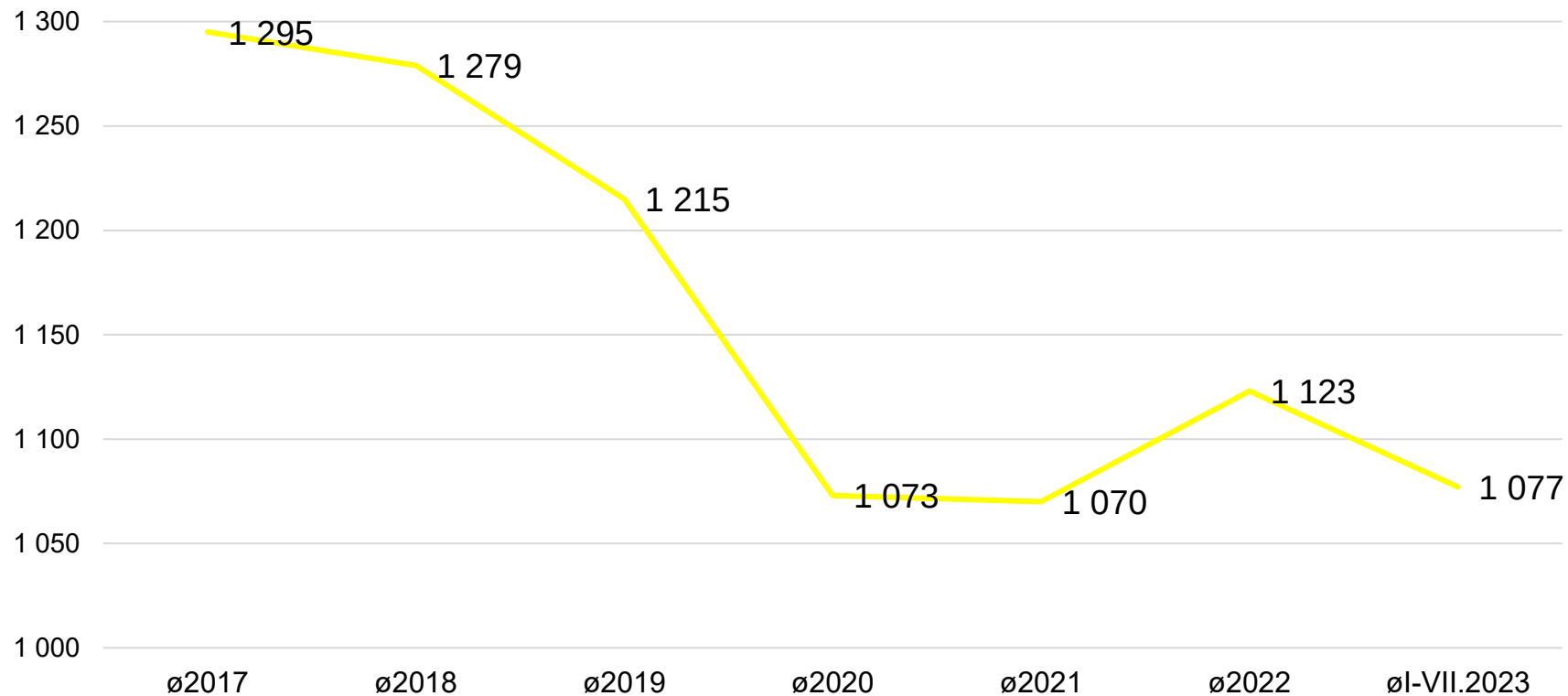


Kern Technologie Werk Hranice

- Stanzen (Stanzzentrum) - automatisiert
- Laser
- Abkannten (automatisiert)
- Automatisiertes Schweißen (Robots)
- Bearbeiten (CNC Fräsmaschinen)
- Oberflächebehandlung (Lackieren, pulver/nass, Verzinken)
- Montage und IBN Mechanik/Elektrik

Personal

TOTAL HRANICE



Schlüsseldaten

Zusammengefasst

✓ Produktionsfläche Areal + Möglich. Kaserne	75.000 m ² + (35.000 m ²)
✓ Landfläche Areal + Kaserne	152.000 m ² + 65.000 m ²
✓ Mitarbeiteranzahl	1.100 MA
✓ Direktproduktionsstunden	1.000.000 h
✓ Materialverbrauch	32.000 Tonnen/Jahr
✓ Speditionsdaten	4.500 LKW/Jahr
✓ Energieverbrauch	10.000 MWh/Jahr

Technologien

Feinblechbearbeitung
Stanzen (5 ST)



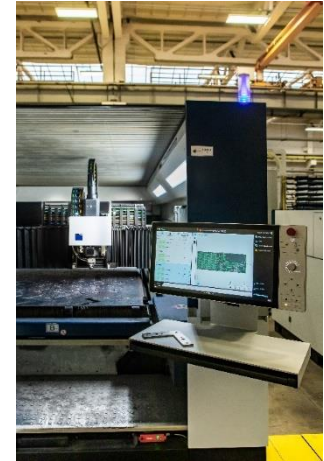
CNC Stanz-Nibbelanlagen

Grobblechbearbeitung
Laser (3 ST)



Leistung: 6 kW

TruLaser 5040 Fibre
(2 ST)



Technologien

Grobblechbearbeitung
Entrgraten / Richten (3 ST)



Technologien

Abkanten (20 ST) – max. Abkantlänge 4m



TruBend Cell 7000 und TruBend Cell 5000



Technologien

Profilbearbeitung
Sägen NC gesteuerte Bohr- und
Sägeanlage Behringer (2 ST)



Profilbearbeitung
Rohrbearbeitung – 2x TubeLaser



Technologien

Schweißen (7 ST Schweißroboter, ca 140 Schweißer)



Kleinschweißgruppen – bis 0,5 kg Gewicht
Große Schweißbaugruppen – bis 12 m Länge und
10 Tonnen Gewicht



Technologien

Mechanische Bearbeitung



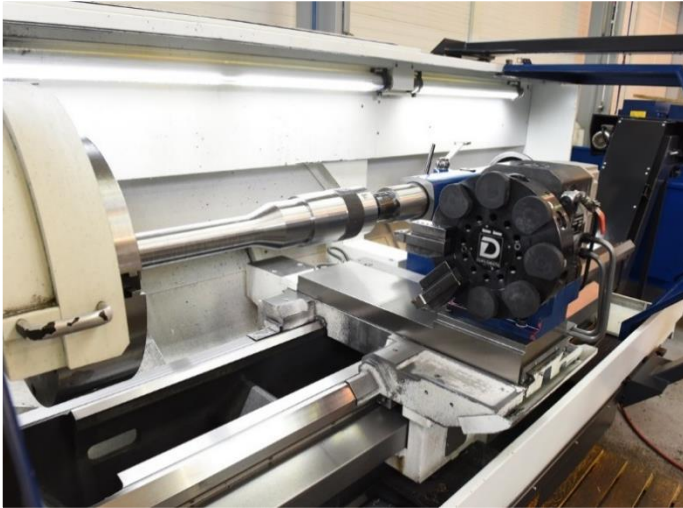
NC Bohr-/Fräszentrum für Großteile – WF 13 CNC



NC Portal-Bohr-/Fräszentrum für Großteile
TYC FSGC 300/10

Technologien

Mechanische Bearbeitung



NC-gesteuerte Drehmaschine (2 ST)



CNC Bohren, Fräsen (4 ST)

Technologien

Oberflächenbehandlung – Pulverbeschichtung (2 ST)



Technologien

Oberflächenbehandlung - Nasslackierung



Montage

Elektromontage



Mechanische Montage



Copyright

© 2022 SSI SCHÄFER, all rights reserved

This publication may neither be reproduced, transmitted nor stored in a retrieval system, including but not limited to, written material, printed matter, punch cards, film, microfilm or microfiche, magnetic tapes or discs or any other electronic media form including optically readable tapes or discs, laser discs, and any other form of computer storage, without the prior written consent of SSI SCHAEFER.

Disclosed matters and/or concepts of the present documentation are or will be protected by intellectual property rights.

SSI SCHÄFER